

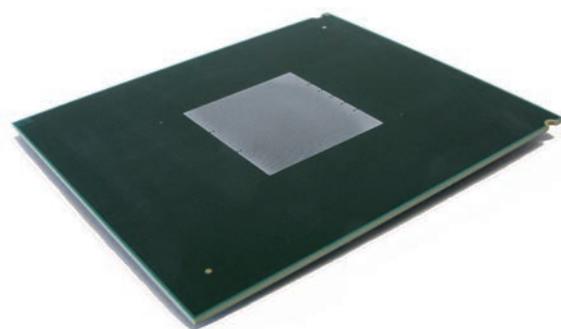
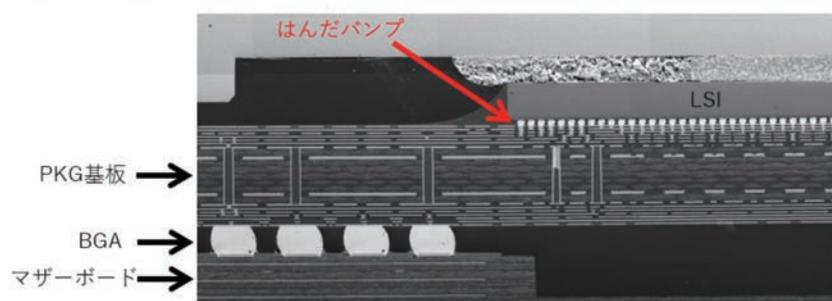
# 次世代高性能パッケージ基板

高性能パッケージ基板 “GigaModuleシリーズ” で、次世代パッケージへの道を切り開く

## ラージダイに最適な大型高性能FC-BGA向けパッケージ基板

- □100mmを超える基板サイズ、16段超の多段ビルドアップに対応
- 厚銅コア含む多種の材料で、高放熱、大電流への対応が可能
- 設計～製造までの一貫対応で、少量多品種、短納期対応を実現

### 多ピンLSIの実装例

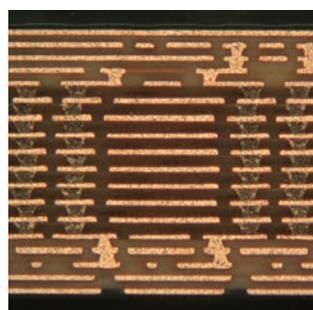
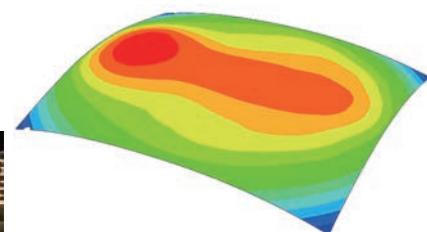


大型パッケージ基板  
サイズ:  $\geq 72\text{mm} \times 60\text{mm}$   
層構成:  $\geq 16$  Layers

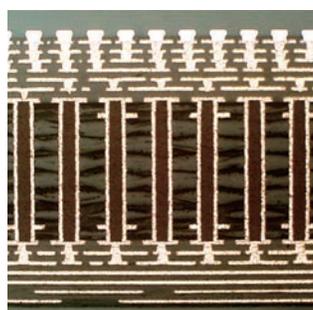
## GHz帯高速信号伝送に対応

- 全層IVH構造や表面が平滑な配線により、更なる高速化/高密度化を実現
- 高密度なVia接続や電源層の厚銅化により、電源系の低インダクタンス化や低電圧大電流化にご対応
- 高速伝送や高放熱に最適な基板ソリューションをご提供

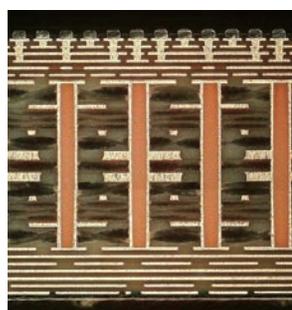
高温時反りシミュレーション



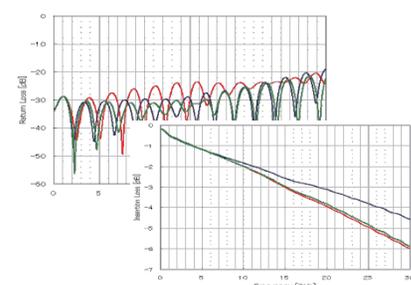
全層IVH



高密度IVH



厚銅配線



高速伝送特性

